

新恒汇电子股份有限公司

关于募集资金具体运用情况

一、募集资金运用计划

公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第一届董事会第三次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票募集资金运用及可行性分析的议案》，公司募集资金扣除发行费用后将投资于“高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目”和“研发中心扩建升级项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目	45,597.01	45,597.01
2	研发中心扩建升级项目	6,266.12	6,266.12
合计		51,863.13	51,863.13

二、募集资金使用管理制度

2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、资金用途变更、管理与监督等方面进行了明确的规定。

公司董事会负责募集资金管理制度的有效执行。本次募集资金到位后，将存放于董事会决定的专项账户。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议，并严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用管理的各项规定执行。

三、募集资金投入的时间周期和进度

1、高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目

高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目建设期 24 个月，项目建设期主要工作内容有：项目的工程设计及准备工作、土建工程、装修及水电工程、设备购置及安装调试、人员招聘及培训、试运行与验收。

2、研发中心扩建项目

研发中心扩建项目建设期 18 个月，主要工作内容有：工程设计及准备工作、装修工程、设备及软件购置及安装调试等。

四、项目环保情况

1、高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目

高密度 QFN/DFN 封装材料产业化项目建成后主要从事高密度 QFN/DFN 蚀刻引线框架的生产，生产过程中仅排放少量的废水和废渣，基本不排放废气，噪声能够符合国家标准。对噪声较大的机械设备应采取相应消音、减震及隔离措施，减低噪声强度，满足工业企业厂界噪声标准要求。电镀工序产生的污泥等废料采用集中堆放，定期处理。垃圾另外集中堆放，外运至环卫部门指定地点，不会对环境产生重大污染。

2、研发中心扩建项目

研发中心扩建项目主要研发集成电路模块封装测试、引线框架相关产品及技术，运营过程基本无“三废”排放。实验室配备有多种研发设备和测试设备，主要能耗为电能，研发过程不会产生有害物质及气体。研发中心扩建项目在建设期间与建成后只会存在少量的生活垃圾和研发、检测过程中产生的废纸等固体废弃物，对周围环境不存在重大污染。

（以下无正文）

（此页无正文，为《新恒汇电子股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》
之盖章页）



新恒汇电子股份有限公司

2025 年 5 月 30 日